⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出額公開

@ 公開特許公報(A) 平4-98864

Olnt. Cl.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)3月31日

H 01 L 23/50

Y 9054-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

樹脂封止型半導体装置

②特 頭 平2-216146

②出 顕 平2(1990)8月16日

の発 明 者 高 崎 由 佳 子 の出 顕 人 九州日本電気株式会社 熊本県熊本市八幡町100番地 九州日本電気株式会社内

熊本県熊本市八幡町100番地

②出 頭 人 九州日本電気株式会社 ②代 理 人 弁理士 内 原 著

明 總 書

発明の名称

视频对止应半等体装置

特許請求の範囲

半導体チャブを含んで対止した観覧体と、質記 半導体チャブと電気的に接続して質記御器体の外 部に導出した外部リードとを有する観覧対止型半 等体質質において、質記外部リードの舞団より開 合う外部リードへ向けて突出した支持部と、預合 う質記支持部の間に介在させて複合う支持部を正 に連結する絶縁体とを備えたことを特徴とする観 野灯止型半導体装置。

発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は製造対止売半等体数量に関する。

〔従来の技術〕

従来の御覧対止型半導体装置は、第5回及び第

6四に示すように、アイランド1の周囲に配置して設けた内部リード2と、内部リード2に接続して接続して接続が必要が変に設けた外部リード4を発して支持するタイパー5とを有してリードフレームを指定し、アイランド1の上に半導体チャブを搭載して出版し、アイランド1の上に半導体チャブを搭載して出版し、外部リード4をリードフレームから切除し、タイパー5を切除し、外部リード4を製造して半導体装置を形成する。

(発明が解決しようとする異常)

上述した従来の報酬對止型半導体製置は、外部 リードが個別体より平行に失々独立して専出され ているので、外部リードが曲がる等の変形を生じ 実験時に平田付の信頼性が低下するという欠点が ある。

(复麗を解決するための手段)

本見明の御路対止収率等体装置は、半導体チャ アを含んで対止した樹脂体と、前記半導体チャア と電気的に指載して前記樹脂体の外部に導出した 外部リードとを有する樹脂対止型半導体装置にお いて、前記外部リードの舞曲より指含う外部リードへ向けて突出した支持部と、用合う質記支持部の同に介在させて用合う支持部を互に連結する他 ・純体とを構えている。

(実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明する。

第1四及び第2回は本発明の第1の実施例を設 明するためのリードフレームの平面四及び半導体 装置の側面回である。

う外部リード相互同を連絡することにより、外部 からの哲学によるリード変形の防止、及び実験時 の半田付の信頼性を向上させるという効果を有す る。

図面の簡単な説明

第1四及び第2回は本元明の第1の実施例を投 明するためのリードフレームの平面四及び半等体 設定の舞画図、第3回及び第4回は本先明の第2 の実施例を説明するためのリードフレームの平面 回及び半等体験型の舞画図、第5回及び第6回は 提来のリードフレームの一例を示す平面回及び半 単位数型の個面図である。

1 … アイランド、2 …内部リード、3 … 密路対止保域、4 …外部リード、5 … タイパー、6 … 支持部、7 … 地線体、8 … 密路体。

代理人 弁理士 內 原 警

ドフレームが構成される。

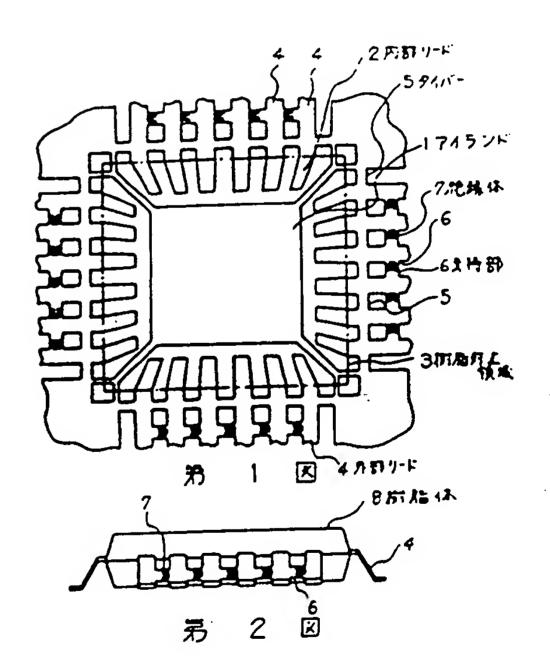
次に、第2回に示すようにアイランド上に半年 体チップ(20元せず)を搭載し、半期体チップと 内部リード間を電気的に接続し、密距体8により 密野上領域内を対止し、リードフレームより外 部リード4及びテイバーを切離し、外部リード4 を整形して半導体装置を構成する。

第3回及び第4回は本売明の第2の実施例を設明するためのリードフレームの平面回及び半導体設置の質面包である。

第3回及び第4回に示すように、保合う外配リード4の側面に設けた支持部6が影覧対止保証3の近時に設けられ、タイパー5が支持部6の外側に設けられている以外は第1の実施例と開催の代表を有しており、支持部6を連結する地線体7を観路対止工程と同時に形成でき、製造工程を信号できる効果を有する。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、外部リードの便面に設けた支持部の間に絶縁体を介在させて指合



特爾平4-98864(3)

